

2015年4月21日

## 高純度フッ化水素の供給体制を強化

—半導体製造における用途拡大に対応—

昭和電工株式会社（社長：市川 秀夫）は、半導体製造用特殊ガスのひとつである高純度 HF（フッ化水素）の供給体制を強化します。本年 3 月に川崎事業所にある既存設備の生産能力を従来の 2 倍に引き上げるとともに、中国に新たに製造設備を建設することを決定しました。

高純度 HF は、半導体の製造工程において主にクリーニング\*に用いられるガスですが、近年、化学的酸化物除去処理（Chemical Oxide Removal：COR）と呼ばれるドライエッチング\*\*工程においても、同ガスの使用が増えています。エッチング用途に求められる高純度を維持するには技術的課題が多い中、当社は独自の精製技術と保存容器内での品質の長期安定化により、同用途における高純度 HF の採用を拡大してまいりました。

化学的酸化物除去処理は、従来のプラズマエッチングやウエットエッチングに代わる微細化エッチングとして注目されており、同工程で使用する高純度 HF の需要も旺盛であることから、川崎事業所の製造設備の増強を行い、本年 3 月に工事を完了しました。

また今回、中国国内のお客様向けに、製造拠点の複数化による迅速かつ柔軟な供給体制を構築する目的から、100%出資の子会社「上海昭和電子化学材料有限公司」（SSE、中国上海市）内に製造設備を建設することを決定しました。同設備は川崎事業所と同等の生産能力を予定しており、今月着工し、本年中の稼働を目指します。

高純度 HF は薬液によるウエットエッチングに比べて生産性の向上が図れることや、プラズマを利用したプラズマエッチングに比べて低コスト化が図れることから、将来的にも同用途での市場は拡大するものと見込まれます。当社は独自技術による一層の品質強化と安定した供給体制により、需要拡大に対応してまいります。

以上

\* クリーニング：成膜の工程で使われるCVD炉に付着する不要な化学物質を取り除くこと

\*\* ドライエッチング：反応性の気体（ガス等）によって基板上の薄膜（酸化膜）に微細な溝や孔を刻み、電子回路等を作ること

